

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成30年6月7日(2018.6.7)

【公開番号】特開2017-54754(P2017-54754A)

【公開日】平成29年3月16日(2017.3.16)

【年通号数】公開・登録公報2017-011

【出願番号】特願2015-179134(P2015-179134)

【国際特許分類】

H 0 1 B 7/02 (2006.01)

H 0 1 B 3/30 (2006.01)

H 0 1 B 3/42 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

H 0 1 B 13/14 (2006.01)

H 0 1 F 5/06 (2006.01)

H 0 2 K 3/30 (2006.01)

【F I】

H 0 1 B 7/02 A

H 0 1 B 7/02 Z

H 0 1 B 3/30 J

H 0 1 B 3/42 G

H 0 1 B 13/00 5 1 7

H 0 1 B 13/14 Z

H 0 1 F 5/06 Q

H 0 2 K 3/30

【手続補正書】

【提出日】平成30年4月20日(2018.4.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

導体と、

前記導体の外周を被覆する内層および前記内層の外周を被覆する外層を有する絶縁層と、
を備え、

前記内層が、前記導体に接触しており、

前記内層が、ポリエーテルエーテルケトン樹脂を含む樹脂組成物（A）から形成され、
前記外層が、ポリフェニレンサルファイド樹脂を含む樹脂組成物（B）から形成され、
前記内層および前記外層のそれぞれの結晶化度が 95% 以上である、絶縁電線。

【請求項 2】

前記内層の厚さは、40 μm 以上 150 μm 以下である、請求項 1 に記載の絶縁電線。

【請求項 3】

前記外層の厚さは、150 μm 以下である、請求項 1 又は 2 に記載の絶縁電線。

【請求項 4】

導体の外周に、ポリエーテルエーテルケトン樹脂を含む樹脂組成物（A）を前記導体に
接触するように押し出して被覆させる第 1 の被覆工程と、

前記樹脂組成物（A）を硬化させて内層を形成する内層形成工程と、

前記内層の外周に、ポリフェニレンサルファイド樹脂を含む樹脂組成物（Ｂ）を押し出して被覆させる第２の被覆工程と、

前記樹脂組成物（Ｂ）を硬化させて外層を形成する外層形成工程と、を有し、

前記内層形成工程では、前記樹脂組成物（Ａ）を再結晶化温度以上融点未満の温度で熱処理して再結晶させることにより前記内層の結晶化度を９５％以上とし、

前記外層形成工程では、前記樹脂組成物（Ｂ）を再結晶化温度以上融点未満の温度で熱処理して再結晶させることにより前記外層の結晶化度を９５％以上とする、絶縁電線の製造方法。

【請求項５】

前記第１の被覆工程の前に、前記導体を前記樹脂組成物（Ａ）の融点以上の温度まで予備加熱する予備加熱工程をさらに有する、請求項４に記載の絶縁電線の製造方法。